

株式会社 FUJI 将参展“JISSO PROTEC 2025”

新产品“智能存储站”首次亮相，使自动化范围延伸到生产准备工序

本公司株式会社 FUJI(公司总部：爱知县知立市、代表取缔役社长：五十棲 丈二、以下简称“FUJI”) 将于 2025 年 6 月 4 日(星期三) ~ 6 日(星期五) 参展在日本东京有明国际展览中心举办的“JISSO PROTEC 2025”展(第 26 届)。在本次展会上，新产品“智能存储站”将首次亮相。我们将通过实机演示来介绍 FUJI 的最新解决方案。它与 FUJI 最先进的贴片机--NXTR A 机型及各种生产准备支援设备联动，不仅让生产区实现了自动化，还将自动化的范围延伸到了生产准备区。



< 3 大看点 >

1. 新产品“智能存储站”首次亮相，现场演示生产准备区的作业自动化
2. FUJI 的最新技术展示：根据生产应用推荐最佳解决方案
3. 综合生产系统 Nexim：通过丰富的功能和全新的排产工具支援生产现场

[免费观展登录，请点击此链接](#)

1. 首次公开新产品“智能存储站”，将实际演示生产准备区的作业自动化

将在本次展会上首次亮相的“智能存储站”是一款支持生产准备区的供料器存储与供应的新单元，可以大幅减少操作员的作业工时和作业负担。我们将展示最新的技术，将迄今为止以生产线为中心的自动化进一步延伸到生产准备区，推动 SMT 车间实现全面自动化。

在展会现场，我们将结合 FUJI 最先进的贴片机“NXTR A 机型”、各种线外换线支援单元以及“智能存储站”进行

演示。通过融入了最新的自动化与省人化解决方案的实机演示，您可以近距离了解 FUJI 的自动化运用。

此外，有客户已经引进了以“NXTR A 机型”为核心的“FUJI Smart Factory(FSF)”。在客户的协作下，我们将介绍通过生产现场的自动化来实现生产力最大化的案例。



新产品“智能存储站”

2. FUJI 的最新技术：根据生产应用推荐最佳解决方案

●面向 SiP/汽车电子 ··· 贴片机“NXTR S 机型”+首次公开亮相的助焊剂浸渍单元

“NXTR S 机型”是一款贴装精度高达 $\pm 10\mu\text{m}$ ，处于行业最高水准的先进贴片机。近年来，在 SiP*制造中，WLCSP*的锡球越来越微型化。为此，我们研发了新的助焊剂浸渍单元，配有专用的浸渍盘和刮刀，可以应对 $10\mu\text{m}$ 这类膜厚超薄的助焊剂转印。将在本次展会首次展出。

●面向服务器/工业设备 ··· 贴片机“AIMEXR”+首次参与现场演示的 RHDH 工作头

AIMEXR 是一款既能对应各种生产形态又具有很强的灵活性的贴片机。展出的 RHDH 工作头适用于各种尺寸的元件：从 $0.4\text{mm} \times 0.2\text{mm}$ 的极小片式元件到用于服务器和工业设备的 $200\text{mm} \times 150\text{mm}$ 的大型连接器以及 GPU 等。

●面向插装工序 ··· 插件机“sFAB-D”、“SmartWing BA”

“sFAB-D”和“SmartWing BA”是能让原先由人工负责的插件工序实现自动化的插件机。在 FUJI 展位上，将由 FUJI 工程师进行演示。

*SiP(System in Package): 将多个芯片封装在 1 个封装内的半导体封装

*WLCSP(Wafer-Level Chip Size Package): 封装尺寸与芯片同等大小的半导体封装

※什么是 FUJI Smart Factory(FSF)

这是一种融入了 FUJI 自研技术的独自的智能工厂构想。这些技术包括：使“生产准备”、“换线”、“补料”、“各工序间的搬运”等人工操作实现自动化的技术、借助以数字平台为基础的作业支援系统来大幅提高工作效率进而使生产线不再依赖人工的技术。

3. 综合生产系统 Nexim：通过丰富的功能和全新的排产工具支援生产现场

“Nexim”是一款综合生产系统，标准功能包括生产所需的编程、工厂监控、物料和 MSD*管理、保养管理、追溯和排产工具等。持与客户系统联动及 M2M 联动，通过数据聚合实现对生产整体的统一管理。

此外，新的排产工具还配备了便捷易用的生产计划创建功能和排产辅助功能。大幅提升繁杂的排产作业的效率，提升生产准备的速度和准确性。

*MSD(Moisture Sensitive Device)：湿敏元件

免费研讨会举办通知

在为期三天的展会期间，本公司将举办各种主题的免费研讨会，内容涵盖 FSF 的进化、印刷机的优化技术以及端侧 AI 和贴装技术的最前沿这些方面，力争为引领贴装行业迈上新台阶做出贡献。

日期	研讨会主题
6 月 4 日(星期三)14:05~14:50	不断进化的 FUJI Smart Factory --3 年来的发展轨迹与未来的挑战
6 月 5 日(星期四) 15:15~16:00	通过指定周期时间来给出印刷参数 --Printing Navigator 的介绍
6 月 6 日(星期五) 11:45~12:30	制造业将面临怎样的变革？端侧 AI 和贴装技术的最前沿 --围绕“Target ZERO”来展开的 FUJI 技术研发线路图 2030 的介绍

[点击这里，申请参加研讨会](#)

参展概要

展 会 名：JISSO PROTEC 2025 展(第 26 届)
举 办 时 间：2025 年 6 月 4 日(星期三)~6 月 6 日(星期五) 10:00~17:00
举 办 地 点：日本东京有明国际展览中心
展 位：东 4 展厅 4G-09
主办方官方网站：<https://www.jissoprotec.jp/>

公司概况

公司名称：株式会社 FUJI
法人代表：代表取缔役社长 五十棲 丈二
公司地址：爱知县知立市山町茶碓山 19 邮编：472-8686
成立时间：1959 年 4 月
事业内容：电子元件贴装机器人(贴片机)以及数控机床的研发、制造、销售
注册资金：58.78 亿日元
网 站：<https://www.fuji.co.jp/cn/> (官方网站)
<https://smt.fuji.co.jp/cn/> (SMT 专用网站)

关于产品展示的咨询窗口

株式会社 FUJI 营业企画部 展会负责人 TEL +81-566-81-8263

各种媒体的咨询窗口

株式会社 FUJI 经营企画部 宣传负责人 [Contact form](#)